(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-179731 (P2002-179731A)

(43)公開日 平成14年6月26日(2002.6.26)

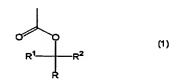
| | | | | | | | - 10/0-40 |
|--------------|-------|-----------------------------|---------|----------|------|-----------------|-------------|
| (51) IntCl.7 | | 識別記号 | FΙ | | | | テーマコート*(参考) |
| C 0.8 F | 20/16 | | C08F | 20/16 | | | 2H025 |
| | 22/18 | | | 22/18 | | | 4J002 |
| | 22/40 | | | 22/40 | | | 4J100 |
| | 32/08 | | | 32/08 | | | • |
| C08K | 5/00 | | C08K | 5/00 | | | |
| | · | 審查請求 | 大韻求 請 | 求項の数7 | OL | (全 25 頁) | 最終頁に続く |
| (21)出願番号 | | 特願2000-383217(P2000-383217) | (71)出顧 | 人 000002 | 2060 | | |
| | | | | 信越化 | 学工業 | 株式会社 | |
| (22)出顧日 | | 平成12年12月18日(2000.12.18) | | 東京都 | 千代田 | 区大手町二 | 丁目6番1号 |
| | | | (71) 出顧 | 人 000005 | 821 | | |
| | | | | 松下電 | 器産業 | 株式会社 | |
| | | | | 大阪府 | 門真市 | 大字門真100 | 6番地 |
| | | | (71)出頭 | | | | |
| | | | | | | 子株式会社 | |
| | | | | | | 大字冲字部 | 7253.2整4的 |
| | | | (74)代理 | | | χ 1 11 1 μμ. | ,000 E /G |
| | | | (14)104 | | | 1846 () | 外1名) |
| | | | | 开理工 | 小品 | 隆司(| (1.14) |
| | | | | | | | 最終質に続く |

(54) 【発明の名称】 高分子化合物、化学増幅レジスト材料及びパターン形成方法

(57)【要約】

【解決手段】 下記一般式(1)で示される基を有する 高分子化合物。

【化1】



(式中R¹、R¹は水素原子、フッ素原子、又は炭素数1~20の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、又はフッ素化されたアルキル基であり、R¹、R²の少なくとも1つはフッ素を含有する。Rは炭素数3~20の少なくとも1つの環により形成される環状アルキル基を示す。)【効果】 本発明のレジスト材料は、高エネルギー線に感応し、200nm以下、特に170nm以下の波長における感度が優れているうえに、エステル側鎖の環状アルキル基の導入によりプラズマエッチング耐性が向上し、それと同時に優れた解像性を有することがわかっ

た。従って本発明のレジスト材料は、これらの特性により、特にF₂エキシマレーザーの露光波長での吸収が小さいレジスト材料となりうるもので、微細でしかも基板に対して垂直なパターンを容易に形成でき、このため超LSI製造用の微細パターン形成材料として好適である。

【特許請求の範囲】

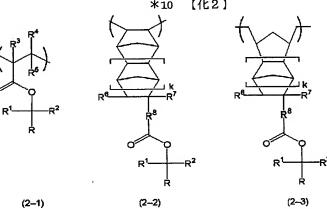
下記一般式(1)で示される基を有する 【請求項1】 高分子化合物。

【化1】

$$\begin{array}{c|c}
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\$$

* (式中R1、R1は水素原子、フッ素原子、又は炭素数1 ~20の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、又はフッ 素化されたアルキル基であり、R1、R1の少なくとも1 つはフッ素を含有する。 Rは炭素数3~20の少なくと も1つの環により形成される環状アルキル基を示す。) 【請求項2】 下記一般式(2-1)、(2-2)、 □ (2-3)、(2-4)、(2-5)で示されるいずれ かの部分構造を有することを特徴とする請求項1 に記載 の高分子化合物。





(2-4)

(2-5)

(式中R1、R1は水素原子、フッ素原子、又は炭素数1 ~20の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、又はフッ 素化されたアルキル基であり、R1、R1の少なくとも1 つはフッ素を含有する。Rは炭素数3~20の少なくと も1つの環により形成される環状アルキル基を示す。R "~R'は水素原子、フッ素原子、炭素数1~20の直鎖 状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化され たアルキル基である。R°及びR'は水素原子、メチル 基、又はCH,CO,R°を示す。R°は炭素数1~20の 直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基、又は置換ア ルキル基である。R®は炭素数1~20の直鎖状、分岐 状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアル キレン基である。kはO又は1である。)

【請求項3】 請求項1又は2に記載の髙分子化合物を 含むことを特徴とするレジスト材料。

(A)請求項1又は2に記載の高分子化 【請求項4】 合物、(B)有機溶剤、(C)酸発生剤を含有すること を特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材料。

【請求項5】 更に塩基性化合物を含有する請求項4記 載のレジスト材料。

【請求項6】 更に溶解阻止剤を含有する請求項4又は 5記載のレジスト材料。

【請求項7】(1)請求項3乃至6のいずれか1項に記 載のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、(2)次 いで加熱処理後、フォトマスクを介して波長300nm 以下の高エネルギー線もしくは電子線で露光する工程。 と、(3)必要に応じて加熱処理した後、現像液を用い て現像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成 方法。

【発明の詳細な説明】 50

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、微細加工技術に適 した化学増幅レジスト材料のベースポリマーとして有用 な高分子化合物並びに化学増幅レジスト材料及びこれを 用いたパターン形成方法に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】近年、 LSIの高集積化と高速度化に伴い、パターンルールの 微細化が求められている。

【0003】微細化が急速に進歩した背景には投影レンズの高NA化、レジストの性能向上、短波長化が挙げられる。レジストの高解像度化及び高感度化に関しては、光照射によって発生する酸を触媒とした化学増幅ポジ型レジスト材料は優れた性能を有するものであり、遠紫外線リソグラフィーにおいて特に主流なレジスト材料になった(特公平2-27660号、特開昭63-27829号公報等に記載)。また、i線(365nm)からKrF(248nm)への短波長化は大きな変革をもたらし、KrFエキシマレーザー用レジスト材料は0.30ミクロンプロセスに始まり、0.25ミクロンルールを20経て、現在0.18ミクロンルールの量産化への適用へと展開している。更には、0.15ミクロンルールの検討も始まっており、微細化の勢いはますます加速されている。

【0004】ArF(193nm)では、デザインルールの微細化を0.13μm以下にすることが期待されているが、ノボラックやポリビニルフェノール系などの従来用いられていた樹脂が193nm付近に非常に強い吸収を持つため、レジスト用のベース樹脂として用いることができない。そこで透明性と必要なドライエッチング 30耐性の確保のため、アクリルやシクロオレフィン系の脂環族系の樹脂が検討された(特開平9-73173号、特開平10-10739号、特開平9-230595号公報、WO97/33198)。

【0005】F₁(157nm) に関しては0.10 μ m以下の微細化が期待されているが、透明性の確保がますます困難になり、ArF用ベースポリマーであるアクリル樹脂では全く光を透過せず、シクロオレフィン系においてもカルボニル結合を有するものは強い吸収を持つことがわかった。また、KrF用ベースポリマーのポリ 40

ビニルフェノールについては、160nm付近に吸収の ウィンドウがあり、若干透過率が向上するものの、実用 的なレベルにはほど違いことが判明した。

[0006]本発明は上記事情に鑑みなさ れたものであり、300nm以下、特に F_{1} (157nm)、 Kr_{2} (146nm)、KrAr(134nm)、 Ar_{2} (121nm)などの真空紫外光における透過率に優れた化学増幅レジスト材料のベースポリマーとして有用な新規高分子化合物並びにこれを含む化学増幅レジスト材料及びこれを用いたパターン形成方法を提供することを目的にする。

[0007]

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】本発明者は上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた結果、含フッ素アルキル基と環状アルキル基を含むエステル樹脂をベースポリマーとして用いることにより、透明性とドライエッチング耐性を確保できるうえに、酸脱離性も兼ね備えた化学増幅レジスト材料が得られることを知見し、本発明をなすに至ったものである。

[0008]即ち、本発明は下記の高分子化合物、化学 増幅レジスト材料及びパターン形成方法を提供する。

[I] 下記一般式(1) で示される基を有する高分子化 合物。

[化3]

$$\mathbb{R}^1$$
 \mathbb{R}^2 (1)

(式中R¹、R²は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 $1 \sim 20$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、又はフッ素化されたアルキル基であり、R¹、R²の少なくとも 1つはフッ素を含有する。Rは炭素数 $3 \sim 20$ の少なくとも 1つの環により形成される環状アルキル基を示す。) [II]下記一般式 (2-1)、 (2-2)、 (2-3)、 (2-4)、 (2-5) で示されるいずれかの部分構造を有することを特徴とする [I] に記載の高分子化合物。

(化4)

(2-2)

R⁸ R⁷ R⁸ (2-3)

0 R R R R 2 (2-4)

(2-1)

(式中R¹、R¹は水素原子、フッ素原子、又は炭素数1~20の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、又はフッ素化されたアルキル基であり、R¹、R¹の少なくとも1つはフッ素を含有する。Rは炭素数3~20の少なくとも1つの環により形成される環状アルキル基を示す。R³~R¹は水素原子、フッ素原子、炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。R゚及びR¹は水素原子、メチル基、又はCH,CO,R゚を示す。R゚は炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基、又は置換アルキル基である。R゚は炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基である。kは0又は1である。)

[I I I] 上記 [I] 又は [I I] に記載の高分子化合物を含むことを特徴とするレジスト材料。

[IV] (A)上記[I]又は[II]に記載の高分子化合物、(B)有機溶剤、(C)酸発生剤を含有することを特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材料。

[V] 更に塩基性化合物を含有する[IV] 記載のレジスト材料。

[VI] 更に溶解阻止剤を含有する[IV] 又は[V] 記載のレジスト材料。

[VII] (1) 上記 [III] 乃至 [VI] のいずれか1項に記載のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、(2) 次いで加熱処理後、フォトマスクを介して波 50

長300nm以下の高エネルギー線もしくは電子線で露光する工程と、(3)必要に応じて加熱処理した後、現像液を用いて現像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成方法。

[0009]本発明者の検討によれば、157nm付近 の透過率を向上させる方法としては、カルボニル基や炭 素 - 炭素間二重結合の数の低減化も一つの方法と考えら れるが、ベースポリマー中へのフッ素原子の導入も透過 率向上に大きく寄与することがわかってきた。実際、ポ リビニルフェノールの芳香環にフッ素を導入したポリマ ーは実用的に近い透過率を得ることができた。しかしな がら、このベースポリマーはF、レーザーのような高エ ネルギー光の照射によりネガ化が進行することが顕著に なり、レジストとしての実用化は難しいことが判明し 40 た。これに対し、アクリル系樹脂やノルボルネン誘導体 由来の脂肪族環状化合物を主鎖に含有する高分子化合物 にフッ素を導入したポリマーは、吸収が低く抑えられる うえにネガ化の問題も解決できることがわかった。特 に、本発明のようにエステル基にフッ索化アルキル基を 導入すると157nm付近での透過率が更に向上すると 共に、環状アルキル基の導入によりドライエッチング耐 性も著しく改善できる。更には、β水素を含有するもの については、酸脱離性も兼ね備えている。

[0010]以下、本発明について更に詳しく説明する。本発明にかかわる高分子化合物は、下記一般式

* [0012]

(1) で示される基を有するものであり、特に下記一般 式(2-1)、(2-2)、(2-3)、(2-4)、 (2-5)で示されるいずれかの繰り返し構造を有する ものである。

【化6】

[0011]

【化5】

【0013】ととで、式中R1、R1は水素原子、フッ素 原子、又は炭素数1~20の直鎖状もしくは分岐状のア ルキル基、又はフッ素化されたアルキル基であり、 R¹、R¹の少なくとも1つはフッ素を含有する。Rは炭 素数3~20の少なくとも1つの環により形成される環 状アルキル基を示す。R'~R'は水索原子、フッ索原 子、炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のア ルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。R⁶及 びR'は水素原子、メチル基、又はCH,CO,R°を示 す。R*は炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環 状のアルキル基、又は置換アルキル基である。R®は炭 素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレ ン基又はフッ索化されたアルキレン基である。kは0又 50 3,3,3-ヘプタフルオロブロビル基などが挙げられ

は1である。

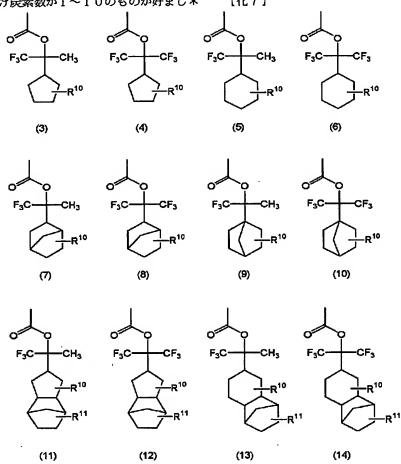
【0014】との場合、炭素数1~20の直鎖状、分岐 40 状もしくは環状のアルキル基としては、メチル基、エチ ル基、プロビル基、イソプロビル基、n-プロビル基、 sec‐ブチル基、tert‐ブチル基、シクロペンチ ル基、シクロヘキシル基、2-エチルヘキシル基、n-オクチル基が例示でき、特に炭素数1~12、とりわけ 炭素数1~10のものが好ましい。なお、フッ素化され たアルキル基は、上記アルキル基の水素原子の一部又は 全部がフッ素原子で置換されたものであり、トリフルオ ロメチル基、2,2,2-トリフルオロエチル基、3, 3, 3-トリフルオロプロピル基、1, 1, 2, 2,

る。また、置換アルキル基としては、上記フッ素化されたアルキル基などが挙げられる。更に、炭素数 $1\sim20$ のアルキレン基、フッ素化されたアルキレン基は、上記炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、フッ素化されたアルキル基から水素原子が 1 個脱離したものが挙げられ、炭素数が $1\sim12$ 、とりわけ炭素数が $1\sim10$ のものが好まし*

* t,°

 $[0\ 0\ 1\ 5]$ とのような高分子化合物としては、例えば下記 $(3)\sim(2\ 0)$ で示される基を有するものが挙げられる。

[0016]



[0017]

【化8】

(19) (20

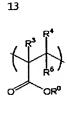
【0018】R¹°、R¹¹は水素原子、炭素数1~6のへテロ原子を含んでもよい1価炭化水素基、又は炭素数1~6のヘテロ原子を介してもよい1価炭化水素基を示す。ヘテロ原子としては、酸素原子、硫黄原子、窒素原子を挙げることができ、-OH、-OR'(R'はアルキル基、以下同じ)、-O-、-S-、-S(=O)-、-NH₂、-NHR'、-NR'₂、-NH-、-NR'₂ 、-NH-、-NR'₂ 、-NH-、-NR' 、-NR' 、-N

ル基、ヒドロキシメチル基、エチル基、ヒドロキシエチル基、プロビル基、イソプロビル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、メトキシ基、メトキシ基、エトキシ基、tert-ブトキシ基等を例示できる。

キル基、以下同じ)、-O-、-S-、-S(=O) [0019]本発明の高分子化合物の多くは式(1)の-、-NH₂、-NHR'、-NR'₂、-NH-、-N コニットだけでも酸脱離性を有するが、酸脱離性を向上R'-として含有又は介在することができる。R'®、R 30 させる点から下記繰り返し単位(21-1)~(21-1)としては、水素原子、アルキル基、ヒドロキシアルキ 5)を導入することができる。

[0020]

【化9】



(21-2)

(8)

(21-1)

(21-5)

【0021】式中、R3~R3、kは上記と同じであり、 R°は酸不安定基を表す。式(21-1)~(21-5) 中の酸不安定基としては種々選定されるが、特に下 記式(22)~(24)で示される基等であることが好* *ましい。 [0022] 【化10】

$$-C_{-14}^{R^{13}}$$

【0023】式(22) におけるR11は炭素数4~2 0、好ましくは4~15の三級アルキル基、各アルキル 40 基がそれぞれ炭素数1~6のトリアルキルシリル基、炭 素数4~20のオキソアルキル基又は上記一般式(2 3) で示される基を示し、三級アルキル基として具体的 には、tert‐ブチル基、tert‐アミル基、1, 1-ジエチルプロピル基、1-エチルシクロペンチル 基、1-ブチルシクロペンチル基、1-エチルシクロへ キシル基、1-ブチルシクロヘキシル基、1-エチル-2-シクロペンテニル基、1-エチル-2-シクロヘキ セニル基、2-メチル-2-アダマンチル基等が挙げら れ、トリアルキルシリル基として具体的には、トリメチ 50 ペンチル基、シクロヘキシル基、2-エチルヘキシル

ルシリル基、トリエチルシリル基、ジメチルーtert ブチルシリル基等が挙げられ、オキソアルキル基とし て具体的には、3-オキソシクロヘキシル基、4-メチ ル-2-オキソオキサン-4-イル基、5-メチル-2 -オキソオキソラン-5-イル基等が挙げられる。a1 は0~6の整数である。

(23)

(24)

[0024]式(23)におけるR''、R''は水素原子 又は炭素数1~18、好ましくは1~10の直鎖状、分 岐状又は環状のアルキル基を示し、具体的にはメチル 基、エチル基、プロビル基、イソプロビル基、n-ブチ ル基、sec‐ブチル基、tert‐ブチル基、シクロ

基、n-オクチル基等を例示できる。R¹¹は炭素数1~18、好ましくは1~10の酸素原子等のヘテロ原子を有してもよい1価炭化水素基を示し、直鎖状、分岐状、環状のアルキル基、これらの水素原子の一部が水酸基、アルコキシ基、オキソ基、アミノ基、アルキルアミノ基*

15

* 等に置換されたものを挙げることができ、具体的には下 記の置換アルキル基等が例示できる。

[0025] 【化11】

$$-(CH_2)_4-OH$$
 $-(CH_2)_2O(CH_2)_3CH_3$ $-CH_2$ $-(CH_2)_2O(CH_2)_2OH$ $-(CH_2)_2OH$ $-(CH_2)_2OH$ $-(CH_2)_3OH$ $-(CH_2)_3OH$

【0026】R''とR''、R''とR''、R''とR''とは環を形成してもよく、環を形成する場合にはR''、R''、R''はそれぞれ炭素数1~18、好ましくは1~10の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。

【0027】上記式(22)の酸不安定基としては、具体的にはtertープトキシカルボニル基、tertープトキシカルボニル基、tertープトキシカルボニルメチル基、tertーアミロキシカルボニル基、tertーアミロキシカルボニル基、1、1ージエチルプロピルオキシカルボニルメチル基、1、1ージエチルプロピルオキシカルボニルメチル基、1ーエチルシクロペンチルオキシカルボニルメチル基、1ーエチルシクロペンチルオキシカルボニルメチル基、1ーエ

チル-2-シクロベンテニルオキシカルボニル基、1-エチル-2-シクロベンテニルオキシカルボニルメチル 基、1-エトキシエトキシカルボニルメチル基、2-テ トラヒドロビラニルオキシカルボニルメチル基、2-テ トラヒドロフラニルオキシカルボニルメチル基等が例示 できる。

【0028】上記式(23)で示される酸不安定基のうち直鎖状又は分岐状のものとしては、具体的には下記の 20 基が例示できる。

[0029]

[化12]

【0030】上記式(23)で示される酸不安定基のうち環状のものとしては、具体的にはテトラヒドロフラン-2-イル基、2-メチルテトラヒドロフラン-2-イル基、テトラヒドロピラン-2-イル基等が例示できる。式(23)としては、エトキシエチル基、ブトキシエチル基、エトキシプロビル基が好ましい。

【0031】次に、式(24)においてR¹⁶、R¹⁷、R 40 16 は炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基等の1価炭化水素基であり、酸素、硫黄、窒素、フッ素などのヘテロ原子を含んでもよく、R¹⁶とR¹⁷、R¹⁶とR¹⁷、R¹⁷とR¹⁸とは互いに結合して環を形成してもよい。

【0032】式(24) に示される三級アルキル基としては、tertーブチル基、トリエチルカルビル基、1-エチルノルボニル基、1-エチルシクロペンチル基、2-(2-メチル)アダマンチル基、2-(2-エチル)アダマンチル基、te 50

rtーアミル基等を挙げることができる。

[0033] また、更に式(24)の三級アルキル基としては、下記に示す式(25)~(40)の三級アルキル基を具体的に挙げることもできる。

[0034]

【化13】

【0035】ととで、R19は炭素数1~6の直鎖状、分 岐状又は環状のアルキル基を示し、具体的にはメチル 基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチ ル基、sec‐ブチル基、n‐ベンチル基、n‐ヘキシ ル基、シクロプロビル基、シクロプロビルメチル基、シ クロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等 を例示できる。R¹⁰は炭素数2~6の直鎖状、分岐状又 は環状のアルキル基を示し、具体的にはエチル基、プロ ビル基、イソプロビル基、n-ブチル基、sec-ブチ 10 ル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、シクロプロピ ル基、シクロプロピルメチル基、シクロブチル基、シク ロペンチル基、シクロヘキシル基等を例示できる。 【0036】R¹¹、R¹¹は水素原子、炭素数1~6のへ テロ原子を含んでもよい1価炭化水素基、炭素数1~6 のヘテロ原子を介してもよい1価炭化水素基を示す。へ テロ原子としては、酸素原子、硫黄原子、窒素原子を挙 げることができ、-OH、-OR'(R'はアルキル 基、以下同じ)、-O-、-S-、-S(=O)-、- NH_2 , -NHR', $-NR'_2$, -NH-, -NR'-20 として含有又は介在することができる。R*1、R*1とし ては、水素原子、アルキル基、ヒドロキシアルキル基、 アルコキシアルキル基、アルコキシ基、アルコキシアル コキシ基などを挙げることができ、これらは直鎖状、分 岐状、環状のいずれでもよい。具体的には、メチル基、 ヒドロキシメチル基、エチル基、ヒドロキシエチル基、 プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、sec-

30 【0037】本発明の高分子化合物は上記単位に加え て、密着性を向上させる点から下記繰り返し単位(4 1)~(76)を導入することができる。 [0038] [化14]

キシ基等を例示できる。

ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、メトキシ 基、メトキシメトキシ基、エトキシ基、tert-ブト

特開2002-179731

[0039]

【化15】

(式中、 R^4 、 R^4 、 R^4 は水素原子、フッ素原子、炭素数 $1\sim20$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ案化されたアルキル基である。また、Meはメチル基である。)

[0040]

【0041】本発明の髙分子化合物を合成する場合、上 50 えるモノマー類と溶媒を混合し、触媒を添加して、場合

記式(1)の基を有する炭素-炭素二重結合を持つモノマー、特に(2-1)~(2-5)の単位を与えるモノマー、更に必要により(21-1)~(21-5)の単位を与えるモノマー及び(41)~(76)の単位を与えるモノマー類と次度を混合し、触度を添加して、場合

によっては加熱又は冷却しながら重合反応を行う。重合 反応は開始剤(又は触媒)の種類、開始の方法(光、 熱、放射線、プラズマなど)、重合条件(温度、圧力、 濃度、溶媒、添加物)などによっても支配される。本発 明の高分子化合物の重合においては、AIBNなどのラ ジカルによって重合が開始されるラジカル重合、アルキ ルリチウムなどの触媒を用いたイオン重合(アニオン重 合)などが一般的である。これらの重合はその常法に従 って行うことができる。

【0042】ラジカル重合開始剤としては特に限定され 10 るものではないが、例として2,2'-アゾビス(4-メトキシー2、4ージメチルバレロニトリル)、2, 2'-アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)、 2, 2-アゾビスイソブチロニトリル、2, 2'-アゾ ビス (2, 4, 4-トリメチルペンタン) などのアゾ系 化合物、 t - ブチルパーオキシピバレート、ラウロイル パーオキサイド、ベンゾイルパーオキサイド、 t -ブチ ルパーオキシラウレートなどの過酸化物系化合物、また 水溶性開始剤としては過硫酸カリウムのような過硫酸 塩、過酸化水素あるいはこれらと亜硫酸水素ナトリウ ム、チオ硫酸ナトリウムのような還元剤との組み合わせ からなるレドックス、更にはこれらに少量の鉄、第一鉄 塩、硝酸銀等を共存させた系等の無機系開始剤、又はジ コハク酸パーオキサイド、ジグルタル酸パーオキシド、 モノコハク酸パーオキシドのような二塩基酸化合物、ア ゾヒスイソブチルアミジン二塩基酸塩等の有機系開始剤 が例示される。重合開始剤の使用量は、種類、重合反応 条件等に応じて適宜変更可能であるが、通常は重合させ るべき単量体全量に対して0.001~5重量%、特に 0.01~1重量%が採用される。

【0043】また、重合反応においては、重合溶媒を用いてもよい。重合溶媒としては、重合反応を阻害しないものが好ましく、代表的なものとしては、酢酸エチル、酢酸 n - ブチルなどのエステル系、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンなどのケトン系、トルエン、キシレン、シクロヘキサンなどの脂肪族又は芳香族炭化水素系、イソブロビルアルコール、エチレングリコールモノメチルエーテルなどのアルコール系、ジエチルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶剤が使用できる。これらの溶剤は単独でもあるいは2種類以上を混合しても使用できる。またドデシルメルカブタンのような公知の分子量調整剤を併用してもよい。

【0044】重合反応の反応温度は重合開始剤の種類あるいは溶媒の沸点により適宜変更され、通常は20~200℃が好ましく、特に50~140℃が好ましい。かかる重合反応に用いる反応容器は特に限定されない。

【0045】とのようにして得られる本発明にかかる重 レート、エチルへブタフルオロブチルアセテート、エチ 合体の溶液又は分散液から、媒質である有機溶媒又は水 ルヘキサフルオログルタリルメチル、エチルー3-ヒド を除去する方法としては、公知の方法のいずれも利用で 50 ロキシー4,4,4-トリフルオロブチレート、エチル

きるが、例を挙げれば再沈濲濾過又は減圧下での加熱留 出等の方法がある。

【0046】なお、上記高分子化合物の重量平均分子量は1,000~1,000,000、特に2,000~100,000とすることが望ましい。

[0047] 本発明の高分子化合物は、レジスト材料、 特に化学増幅型、とりわけ化学増幅ポジ型レジスト材料 のベース樹脂として使用することができる。

[0048]従って、本発明は、(A)上記高分子化合物(ベース樹脂)、(B)有機溶剤、(C)酸発生剤を含有することを特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材料を提供する。

【0049】この場合、これらレジスト材料に、更に (D)塩基性化合物、(E)溶解阻止剤を配合してもよい。

【0050】ここで、本発明で使用される(B)成分の 有機溶剤としては、ベース樹脂、酸発生剤、その他の添 加剤等が溶解可能な有機溶剤であればいずれでもよい。 このような有機溶剤としては、例えばシクロヘキサノ 20 ン、メチルー2-n-アミルケトン等のケトン類、3-メトキシブタノール、3-メチル-3-メトキシブタノ ール、1-メトキシ-2-プロパノール、1-エトキシ - 2 - プロパノール等のアルコール類、プロピレングリ コールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノメ **チルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテ** ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレ ングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコール ジメチルエーテル等のエーテル類、プロピレングリコー ルモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコー 30 ルモノエチルエーテルアセテート、乳酸エチル、ビルビ ン酸エチル、酢酸ブチル、3-メトキシプロピオン酸メ チル、3-エトキシブロピオン酸エチル、酢酸tert ブチル、プロピオン酸tertーブチル、プロピレン グリコールモノtert-ブチルエーテルアセテート等 のエステル類が挙げられる。

[0051]また、フッ素化された有機溶媒も用いるととができる。具体的に例示すると、2-フルオロアニソール、3-フルオロアニソール、4-フルオロアニソール、2、3-ジフルオロアニソール、2、4-ジフルオロアニソール、5、8-ジフルオロー1、4-ベンゾジオキサン、2、3-ジフルオロベンジルアルコール、1、3-ジフルオロー2-ブロバノール、2'、4'-ジフルオロブロピオフェノン、2、4-ジフルオロトルエン、トリフルオロアセトアルデヒドエチルへミアセタール、トリフルオロアセトアミド、トリフルオロエタノール、2、2、2-トリフルオロエチルブチレート、エチルへブタフルオロブチレート、エチルへブタフルオロブチレート、エチルへブタフルオロブチルト・エチルへオログルタリルメチル、エチルー3-ヒドロキシー4 4 4-トリフルオロブチレート。エチル

-2-メチル-4,4,4-トリフルオロアセトアセテ ート、エチルペンタフルオロベンゾエート、エチルペン タフルオロプロピオネート、エチルペンタフルオロプロ ピニルアセテート、エチルパーフルオロオクタノエー ト、エチルー4, 4, 4ートリフルオロアセトアセテー ト、エチルー4,4,4-トリフルオロブチレート、エ チルー4, 4, 4ートリフルオロクロトネート、エチル トリフルオロスルホネート、エチルー3-(トリフルオ ロメチル) ブチレート、エチルトリフルオロビルベー ト、S-エチルトリフルオロアセテート、フルオロシク ロヘキサン、2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフル オロー1ープタノール、1, 1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘプタフルオロー7、7ージメチルー4、6ーオクタン ジオン、1、1、1、3、5、5、5 - ヘプタフルオロ ペンタンー2, 4-ジオン、3, 3, 4, 4, 5, 5, 5-ヘプタフルオロー2-ペンタノール、3,3,4, 4, 5, 5, 5-ヘプタフルオロ-2-ペンタノン、イ ソプロピル4,4,4-トリフルオロアセトアセテー ト、メチルパーフルオロデナノエート、メチルパーフル オロ (2-メチル-3-オキサヘキサノエート)、メチ ルパーフルオロノナノエート、メチルパーフルオロオク タノエート、メチルー2、3、3、3ーテトラフルオロ プロピオネート、メチルトリフルオロアセトアセテー ト、メチルトリフルオロアセトアセテート、1,1, 1, 2, 2, 6, 6, 6-オクタフルオロー2, 4-ヘ キサンジオン、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オク タフルオロー1ーペンタノール、1H, 1H, 2H, 2 H-パーフルオロ-1-デカノール、パーフルオロ (2,5-ジメチル-3,6-ジオキサンアニオニッ ク)酸メチルエステル、2H-パーフルオロ-5-メチ ル-3, 6-ジオキサノナン、1H, 1H, 2H, 3 H, 3H-パーフルオロノナン-1, 2-ジオール、1 H, 1H, 9H-パーフルオロ-1-ノナノール、1 H. 1H-パーフルオロオクタノール、1H, 1H, 2 H, 2H-パーフルオロオクタノール、2H-パーフル オロ-5, 8, 11, 14-テトラメチル-3, 6, 9, 12, 15-ペンタオキサオクタデカン、パーフル オロトリブチルアミン、パーフルオロトリヘキシルアミ ン、パーフルオロー2,5,8-トリメチルー3,6, 9-トリオキサドデカン酸メチルエステル、パーフルオ ロトリペンチルアミン、パーフルオロトリプロピルアミ ン、1H, 1H, 2H, 3H, 3H-パーフルオロウン デカン-1,2-ジオール、トルフルオロブタノール 1, 1, 1-トリフルオロ-5-メチル-2, 4-ヘキ サンジオン、1,1,1-トリフルオロ-2-プロパノ ール、3,3,3ートリフルオロー1ープロパノール、 1, 1, 1-トリフルオロー2-プロピルアセテート、 パーフルオロブチルテトラヒドロフラン、パーフルオロ (ブチルテトラヒドロフラン)、パーフルオロデカリ ン、パーフルオロ(1,2-ジメチルシクロヘキサ

ン)、パーフルオロ(1,3-ジメチルシクロへキサン)、プロピレングリコールトリフルオロメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールメチルエーテルトリフルオロメチルアセテート、トリフルオロメチル酢酸ブチル、3-トリフルオロメトキシプロピオン酸メチル、パーフルオロシクロへキサノン、プロピレングリコールトリフルオロメチルエーテル、トリフルオロ酢酸ブチル、1,1,1-トリフルオロ-5,5-ジメチルー2,4-ヘキサンジオンなどが挙げられる。

【0052】 これらの溶媒は1種を単独で又は2種以上を混合して使用することもできるが、これらに限定されるものではない。本発明では、これらの有機溶剤の中でもレジスト成分中の酸発生剤の溶解性が最も優れているジェチレングリコールジメチルエーテルや1-エトキシー2-プロパノールの他、安全溶剤であるプロビレングリコールモノメチルアセテート及びその混合溶剤が好ましく使用される。

[0053](C)成分の酸発生剤としては、下記一般式(77)のオニウム塩、式(78)のジアゾメタン誘導体、式(79)のグリオキシム誘導体、βーケトスルホン酸誘導体、ジスルホン誘導体、ニトロベンジルスルホネート誘導体、スルホン酸エステル誘導体、イミドイルスルホネート誘導体等が挙げられる。

[0054] (R'') M'K' (77) (但し、式中R''はそれぞれ炭素数1~12の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、炭素数6~20のアリール基、又は炭素数7~12のアラルキル基を示し、M'はヨードニウム、スルホニウムを表し、K'は非求核性対向イオンを表し、mは2又は3である。)

【0055】R¹³のアルキル基としては、メチル基、エ チル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、2-オキ ソシクロペンチル基、ノルボルニル基、アダマンチル基 等が挙げられる。アリール基としては、フェニル基、p -メトキシフェニル基、m-メトキシフェニル基、o-メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、p‐ter t-ブトキシフェニル基、m-tert-ブトキシフェ ニル基等のアルコキシフェニル基、2-メチルフェニル 基、3-メチルフェニル基、4-メチルフェニル基、エ チルフェニル基、4-tert-ブチルフェニル基、4 - ブチルフェニル基、ジメチルフェニル基等のアルキル フェニル基等が挙げられる。アラルキル基としてはベン ジル基、フェネチル基等が挙げられる。K-の非求核性 対向イオンとしては塩化物イオン、臭化物イオン等のハ ライドイオン、トリフレート、1,1,1-トリフルオ ロエタンスルホネート、ノナフルオロブタンスルホネー ト等のフルオロアルキルスルホネート、トシレート、ベ ンゼンスルホネート、4-フルオロベンゼンスルホネー ト、1、2、3、4、5-ペンタフルオロベンゼンスル ホネート等のアリールスルホネート、メシレート、ブタ 50 ンスルホネート等のアルキルスルホネートが挙げられ

*

29

*【化17】

[0056]

る.

N² R²⁴—SO₂—C—SO₂—R²⁵

(78)

(但し、R**、R**は炭素数1~12の直鎖状、分岐状 又は環状のアルキル基又はハロゲン化アルキル基、炭素 数6~12のアリール基又はハロゲン化アリール基又は 炭素数7~12のアラルキル基を示す。)

【0057】R²⁴、R²³のアルキル基としてはメチル 基、エチル基、プロピル基、ブチル基、アミル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、ノルボルニル基、ア ダマンチル基等が挙げられる。ハロゲン化アルキル基としてはトリフルオロメチル基、1,1,1-トリクロロエチル基、ノナフルオロブチル基等が挙げられる。アリール基としてはフェニル基、p-メトキシフェニル基、m-メトキシフェニル基、o-メトキシフェニル基、エトキシフェニル ※

 ※基、p-tert-ブトキシフェニル基、m-tert -ブトキシフェニル基等のアルコキシフェニル基、2-メチルフェニル基、3-メチルフェニル基、4-メチル フェニル基、エチルフェニル基、4-tert-ブチル フェニル基、4-ブチルフェニル基、ジメチルフェニル 基等のアルキルフェニル基が挙げられる。ハロゲン化ア リール基としてはフルオロフェニル基、クロロフェニル 基、1、2、3、4、5-ペンタフルオロフェニル基等 が挙げられる。アラルキル基としてはベンジル基、フェ ネチル基等が挙げられる。

30

[0058] [化18]

$$R^{27}$$
 R^{28} R^{26} R^{26}

(但し、式中、R²⁶、R²⁷、R²⁸は炭素数1~12の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基又はハロゲン化アルキル基、炭素数6~12のアリール基又はハロゲン化アリール基、又は炭素数7~12のアラルキル基を示す。R²⁷、R²⁸は互いに結合して環状構造を形成してもよく、環状構造を形成する場合、R²⁷、R²⁸はそれぞれ炭素数1~6の直鎖状、分岐状のアルキレン基を示す。)【0059】R²⁶、R²⁷、R²⁸のアルキル基、ハロゲン化アルキル基、アリール基、ハロゲン化アリール基、アラルキル基としては、R²⁴、R²³で説明したものと同様の基が挙げられる。なお、R²⁷、R²⁸のアルキレン基としてはメチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ヘキシレン基等が挙げられる。

【0060】酸発生剤として具体的には、例えばトリフ ルオロメタンスルホン酸ジフェニルヨードニウム、トリ フルオロメタンスルホン酸(p-tert-ブトキシフ ェニル)フェニルヨードニウム、p-トルエンスルホン 酸ジフェニルヨードニウム、p-トルエンスルホン酸 (p-tert-ブトキシフェニル) フェニルヨードニ ウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリフェニルスル ホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸(p-ter t-ブトキシフェニル) ジフェニルスルホニウム、トリ フルオロメタンスルホン酸ビス(p-tert-ブトキ シフェニル) フェニルスルホニウム、トリフルオロメタ ンスルホン酸トリス(p-tert-ブトキシフェニ ル) スルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリフェニ ルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸(p-ter t-ブトキシフェニル) ジフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸ビス (p-tert-ブトキシフェ 50

ニル) フェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸 トリス (p-tert-ブトキシフェニル) スルホニウ ム、ノナフルオロブタンスルホン酸トリフェニルスルホ ニウム、ブタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、 トリフルオロメタンスルホン酸トリメチルスルホニウ ム、p-トルエンスルホン酸トリメチルスルホニウム、 トリフルオロメタンスルホン酸シクロヘキシルメチル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウム、p-トル エンスルホン酸シクロヘキシルメチル(2-オキソシク ロヘキシル) スルホニウム、トリフルオロメタンスルホ ン酸ジメチルフェニルスルホニウム、アートルエンスル ホン酸ジメチルフェニルスルホニウム、トリフルオロメ タンスルホン酸ジシクロヘキシルフェニルスルホニウ ム、p-トルエンスルホン酸ジシクロヘキシルフェニル スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリナフ チルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸シク ロヘキシルメチル (2-オキソシクロヘキシル) スルホ ニウム、トリフルオロメタンスルホン酸(2-ノルボニ ル) メチル(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウ ム、エチレンピス[メチル(2-オキソシクロペンチ ル)スルホニウムトリフルオロメタンスルホナート]、 1, 2'-ナフチルカルボニルメチルテトラヒドロチオ フェニウムトリフレート等のオニウム塩、ビス(ベンゼ ンスルホニル) ジアゾメタン、ピス (p-トルエンスル ホニル) ジアゾメタン、ピス (キシレンスルホニル) ジ アゾメタン、ピス (シクロヘキシルスルホニル) ジアゾ メタン、ビス(シクロペンチルスルホニル)ジアゾメタ ン、ピス (n-ブチルスルホニル) ジアゾメタン、ピス (イソブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(sec

ーブチルスルホニル)ジアゾメタン、ピス(nープロピ ルスルホニル) ジアゾメタン、ビス(イソプロピルスル ホニル) ジアゾメタン、ピス (tertーブチルスルホ ニル) ジアゾメタン、ピス (n-アミルスルホニル) ジ アゾメタン、ピス (イソアミルスルホニル) ジアゾメタ ン、ピス(sec-アミルスルホニル)ジアゾメタン、 ピス (tert-アミルスルホニル) ジアゾメタン、1 **-シクロヘキシルスルホニル-1-(tert-ブチル** スルホニル) ジアゾメタン、1-シクロヘキシルスルホ ニルー1-(tert-アミルスルホニル)ジアゾメタ 10 ン、1-tert-アミルスルホニル-1-(tert - ブチルスルホニル)ジアゾメタン等のジアゾメタン誘 導体、ピス-O-(p-トルエンスルホニル)-α-ジ メチルグリオキシム、ビス・〇・(p-トルエンスルホ ニル) - α - ジフェニルグリオキシム、ビス - O - (p - トルエンスルホニル) - α - ジシクロヘキシルグリオ キシム、ピス-〇-(p-トルエンスルホニル)-2, 3-ペンタンジオングリオキシム、ビス-O-(p-ト ルエンスルホニル) -2-メチル-3, 4-ペンタンジ オングリオキシム、ピスー〇ー(nーブタンスルホニ ル) – α – ジメチルグリオキシム、ピス – Ο – (n – ブ タンスルホニル) - α - ジフェニルグリオキシム、ビス -O-(n-ブタンスルホニル)-α-ジシクロヘキシ ルグリオキシム、ビス-O-(n-ブタンスルホニル) −2,3 −ペンタンジオングリオキシム、ピスー〇− (n-ブタンスルホニル)-2-メチル-3,4-ペン タンジオングリオキシム、ビス-0-(メタンスルホニ ル) -α-ジメチルグリオキシム、ビス-Ο-(トリフ ルオロメタンスルホニル) - α - ジメチルグリオキシ ム、ピス-〇-(1,1,1-トリフルオロエタンスル ホニル) $-\alpha$ - ジメチルグリオキシム、ビス-O-(tert-ブタンスルホニル)-α-ジメチルグリオキシ ム、ピス-〇-(パーフルオロオクタンスルホニル)α-ジメチルグリオキシム、ピス-Ο-(シクロヘキサ ンスルホニル) - α - ジメチルグリオキシム、ビス - O (ベンゼンスルホニル) - α - ジメチルグリオキシ ム、ビス-O-(p-フルオロベンゼンスルホニル)-- ブチルベンゼンスルホニル) - α - ジメチルグリオキ シム、ピス-Ο-(キシレンスルホニル)-α-ジメチ ルグリオキシム、ピス-〇-(カンファースルホニル) - α-ジメチルグリオキシム等のグリオキシム誘導体、 2-(シクロヘキシルカルボニル-2-(p-トルエン スルホニル)プロパン、2-イソプロピルカルボニルー 2- (p-トルエンスルホニル) プロパン等のβ-ケト スルホン誘導体、ジフェニルジスルホン、ジシクロヘキ シルジスルホン等のジスルホン誘導体、p-トルエンス ルホン酸2.6-ジニトロベンジル、p-トルエンスル ホン酸2, 4-ジニトロベンジル等のニトロベンジルス ルホネート誘導体、1,2,3ートリス(メタンスルホ

ニルオキシ) ベンゼン、1,2,3-トリス(トリフル オロメタンスルホニルオキシ)ベンゼン、1,2,3-トリス (p-トルエンスルホニルオキシ) ベンゼン等の スルホン酸エステル誘導体、フタルイミドーイルートリ フレート、フタルイミドーイルートシレート、5ーノル ボルネン-2, 3-ジカルボキシイミド-イルートリフ レート、5-ノルボルネン-2,3-ジカルボキシイミ ドーイルートシレート、5-ノルボルネン-2, 3-ジ カルボキシイミド-イル-N-ブチルトリフレスルホネ ート等のイミドーイルスルホネート誘導体などが挙げら れるが、トリフルオロメタンスルホン酸トリフェニルス ルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸(p-te rt-ブトキシフェニル) ジフェニルスルホニウム、ト リフルオロメタンスルホン酸トリス(p-tert-ブ トキシフェニル) スルホニウム、p-トルエンスルホン 酸トリフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸 (p-tert-ブトキシフェニル) ジフェニルスルホ ニウム、p-トルエンスルホン酸トリス(p-tert - ブトキシフェニル) スルホニウム、トリフルオロメタ 20 ンスルホン酸トリナフチルスルホニウム、トリフルオロ メタンスルホン酸シクロヘキシルメチル(2-オキソシ クロヘキシル) スルホニウム、トリフルオロメタンスル ホン酸(2-ノルボニル)メチル(2-オキソシクロへ キシル)スルホニウム、1,2'-ナフチルカルボニル メチルテトラヒドロチオフェニウムトリフレート等のオ ニウム塩、ビス(ベンゼンスルホニル)ジアゾメタン、 ビス (p-トルエンスルホニル) ジアゾメタン、ビス (シクロヘキシルスルホニル) ジアゾメタン、ビス(n **– ブチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (イソブチル** スルホニル) ジアゾメタン、ビス (sec-ブチルスル ホニル) ジアゾメタン、ピス (n-プロピルスルホニ ル) ジアゾメタン、ピス (イソプロピルスルホニル) ジ アゾメタン、ビス(tert-ブチルスルホニル)ジア ゾメタン等のジアゾメタン誘導体、ビス-〇-(p-ト ルエンスルホニル) - α - ジメチルグリオキシム、ビス -O-(n-ブタンスルホニル)-α-ジメチルグリオ キシム等のグリオキシム誘導体が好ましく用いられる。 なお、上記酸発生剤は1種を単独で又は2種以上を組み 合わせて用いることができる。オニウム塩は矩形性向上 効果に優れ、ジアゾメタン誘導体及びグリオキシム誘導 体は定在波低減効果に優れるため、両者を組み合わせる ことによりプロファイルの微調整を行うことが可能であ

【0061】酸発生剤の添加量は、ベース樹脂100部(重量部、以下同様)に対して0.2~15部が好ましく、0.2部より少ないと露光時の酸発生量が少なく、感度及び解像性が悪い場合があり、15部より多いと透明性が低くなり解像性が低下する場合がある。

[0062] (D) 成分の塩基性化合物は、酸発生剤より発生する酸がレジスト膜中に拡散する際の拡散速度を

抑制することができる化合物が適している。このような 塩基性化合物の配合により、レジスト膜中での酸の拡散 速度が抑制されて解像度が向上し、露光後の感度変化を 抑制したり、基板や環境依存性を少なくし、露光余裕度 やパターンプロファイル等を向上することができる(特 開平5-232706号、同5-249683号、同5 -158239号、同5-249662号、同5-25 7282号、同5-289322号、同5-28934 0号公報等記載)。

【0063】とのような塩基性化合物としては、第一 級、第二級、第三級の脂肪族アミン類、混成アミン類、 芳香族アミン類、複素環アミン類、カルボキシ基を有す る含窒素化合物、スルホニル基を有する含窒素化合物、 水酸基を有する含窒素化合物、ヒドロキシフェニル基を 有する含窒素化合物、アルコール性含窒素化合物、アミ ド誘導体、イミド誘導体等が挙げられる。

【0064】具体的には、第一級の脂肪族アミン類とし て、アンモニア、メチルアミン、エチルアミン、n-プ ロビルアミン、イソプロビルアミン、n-ブチルアミ ン、イソブチルアミン、sec-ブチルアミン、ter t-ブチルアミン、ペンチルアミン、tert-アミル アミン、シクロペンチルアミン、ヘキシルアミン、シク ロヘキシルアミン、ヘプチルアミン、オクチルアミン、 ノニルアミン、デシルアミン、ドデシルアミン、セチル アミン、メチレンジアミン、エチレンジアミン、テトラ エチレンペンタミン等が例示され、第二級の脂肪族アミ ン類として、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジーn -プロピルアミン、ジイソプロピルアミン、ジ-n-ブ チルアミン、ジイソブチルアミン、ジ-sec-ブチル アミン、ジベンチルアミン、ジシクロベンチルアミン、 ジヘキシルアミン、ジシクロヘキシルアミン、ジヘブチ ルアミン、ジオクチルアミン、ジノニルアミン、ジデシ ルアミン、ジドデシルアミン、ジセチルアミン、N, N -ジメチルメチレンジアミン、N. N-ジメチルエチレ ンジアミン、N、N-ジメチルテトラエチレンペンタミ ン等が例示され、第三級の脂肪族アミン類として、トリ メチルアミン、トリエチルアミン、トリーnープロピル アミン、トリイソプロピルアミン、トリーn-ブチルア ミン、トリイソブチルアミン、トリーSec‐ブチルア ミン、トリペンチルアミン、トリシクロペンチルアミ ン、トリヘキシルアミン、トリシクロヘキシルアミン、 トリヘプチルアミン、トリオクチルアミン、トリノニル アミン、トリデシルアミン、トリドデシルアミン、トリ セチルアミン、N, N, N', N'-テトラメチルメチ レンジアミン、N, N, N', N'-テトラメチルエチ レンジアミン、N, N, N', N'-テトラメチルテト ラエチレンペンタミン等が例示される。

【0065】また、混成アミン類としては、例えばジメ チルエチルアミン、メチルエチルプロピルアミン、ベン ジルアミン、フェネチルアミン、ベンジルジメチルアミ 50 としては、例えばアミノ安息香酸、インドールカルボン

ン等が例示される。芳香族アミン類及び複素環アミン類 の具体例としては、アニリン誘導体(例えばアニリン、 N-メチルアニリン、N-エチルアニリン、N-プロピ ルアニリン、N, N-ジメチルアニリン、2-メチルア ニリン、3-メチルアニリン、4-メチルアニリン、エ チルアニリン、プロピルアニリン、トリメチルアニリ ン、2-ニトロアニリン、3-ニトロアニリン、4-ニ トロアニリン、2、4-ジニトロアニリン、2、6-ジ ニトロアニリン、3,5-ジニトロアニリン、N,N-10 ジメチルトルイジン等)、ジフェニル(p-トリル)ア ミン、メチルジフェニルアミン、トリフェニルアミン、 フェニレンジアミン、ナフチルアミン、ジアミノナフタ レン、ピロール誘導体(例えばピロール、2 Hーピロー ル、1-メチルピロール、2、4-ジメチルピロール、 2. 5-ジメチルピロール、N-メチルピロール等)、 オキサゾール誘導体(例えばオキサゾール、イソオキサ ゾール等)、チアゾール誘導体(例えばチアゾール、イ ソチアゾール等)、イミダゾール誘導体(例えばイミダ ゾール、4-メチルイミダゾール、4-メチルー2-フ ェニルイミダゾール等)、ピラゾール誘導体、フラザン 誘導体、ピロリン誘導体(例えばピロリン、2-メチル - 1 - ピロリン等)、ピロリジン誘導体(例えばピロリ ジン、N-メチルピロリジン、ピロリジノン、N-メチ ルピロリドン等)、イミダゾリン誘導体、イミダゾリジ ン誘導体、ピリジン誘導体(例えばピリジン、メチルピ リジン、エチルピリジン、プロピルピリジン、ブチルピ リジン、4-(1-ブチルペンチル) ピリジン、ジメチ ルピリジン、トリメチルピリジン、トリエチルピリジ ン、フェニルピリジン、3-メチル-2-フェニルピリ ジン、4-tert-ブチルピリジン、ジフェニルピリ ジン、ベンジルピリジン、メトキシピリジン、ブトキシ ピリジン、ジメトキシピリジン、1-メチル-2-ピリ ドン、4-ピロリジノピリジン、1-メチル-4-フェ ニルピリジン、2-(1-エチルプロピル)ピリジン、 アミノビリジン、ジメチルアミノビリジン等)、ビリダ ジン誘導体、ピリミジン誘導体、ピラジン誘導体、ピラ ゾリン誘導体、ピラゾリジン誘導体、ピペリジン誘導 体、ピペラジン誘導体、モルホリン誘導体、インドール 誘導体、イソインドール誘導体、1H-インダゾール誘 導体、インドリン誘導体、キノリン誘導体(例えばキノ リン、3-キノリンカルボニトリル等)、イソキノリン 誘導体、シンノリン誘導体、キナゾリン誘導体、キノキ サリン誘導体、フタラジン誘導体、ブリン誘導体、ブテ リジン誘導体、カルバゾール誘導体、フェナントリジン 誘導体、アクリジン誘導体、フェナジン誘導体、1,1 0-フェナントロリン誘導体、アデニン誘導体、アデノ シン誘導体、グアニン誘導体、グアノシン誘導体、ウラ シル誘導体、ウリジン誘導体等が例示される。

【0066】更に、カルボキシ基を有する含窒素化合物

酸、アミノ酸誘導体(例えばニコチン酸、アラニン、ア ルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシン、 ヒスチジン、イソロイシン、グリシルロイシン、ロイシ ン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、リジ ン、3-アミノビラジン-2-カルボン酸、メトキシア ラニン) 等が例示され、スルホニル基を有する含窒素化 合物として3-ピリジンスルホン酸、p-トルエンスル ホン酸ビリジニウム等が例示され、水酸基を有する含窒 素化合物、ヒドロキシフェニル基を有する含窒素化合 物、アルコール性含窒素化合物としては、2-ヒドロキ シピリジン、アミノクレゾール、2,4-キノリンジオ ール、3-インドールメタノールヒドレート、モノエタ ノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールア ミン、N-エチルジエタノールアミン、N, N-ジエチ ルエタノールアミン、トリイソプロパノールアミン、 2, 2'-イミノジエタノール、2-アミノエタノー ル、3-アミノ-1-プロパノール、4-アミノ-1-ブタノール、4-(2-ヒドロキシエチル)モルホリ ン、2-(2-ヒドロキシエチル)ピリジン、1-(2 ーヒドロキシエチル) ビベラジン、1-[2-(2-ヒ*20

35

(式中、R²³、R²³、R²³、R²³、R²³はそれぞれ独立 して直鎖状、分岐鎖状又は環状の炭素数1~20のアル キレン基、R³¹、R³¹、R³¹、R³¹、R³⁸は水素原子、 炭素数1~20のアルキル基又はアミノ基を示し、R32 ŁR"、 R"ŁR"、 R"ŁR"、 R"ŁR"ŁR"、 R''とR'"はそれぞれ結合して環を形成してもよい。 n、o、pはそれぞれ0~20の整数である。但し、 n、o、p=0のとき、R**、R**、R**、R**、R** は水素原子を含まない。)

[0069] ここで、R²⁸、R³⁰、R³¹、R³⁵、R³⁶の アルキレン基としては、炭素数1~20、好ましくは1 ~10、更に好ましくは1~8のものであり、具体的に 40 は、メチレン基、エチレン基、n-プロピレン基、イソ プロピレン基、n-ブチレン基、イソブチレン基、n-ペンチレン基、イソペンチレン基、ヘキシレン基、ノニ レン基、デシレン基、シクロペンチレン基、シクロヘキ シレン基等が挙げられる。

【0070】また、R31、R33、R34、R37、R38のア ルキル基としては、炭素数1~20、好ましくは1~ 8、更に好ましくは1~6のものであり、これらは直鎖 状、分岐状、環状のいずれであってもよい。具体的に は、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピ 50 シプロポキシ)エチル}アミン、トリス[2-{(2-

* ドロキシエトキシ) エチル] ピペラジン、ピペリジンエ タノール、1-(2-ヒドロキシエチル) ピロリジン、 1 - (2 - ヒドロキシエチル) - 2 - ピロリジノン、3-ピペリジノ-1,2-プロパンジオール、3-ピロリ ジノー1,2-プロパンジオール、8-ヒドロキシユロ リジン、3-クイヌクリジノール、3-トロパノール、 1-メチル-2-ピロリジンエタノール、1-アジリジ ンエタノール、N-(2-ヒドロキシエチル) フタルイ ミド、N-(2-ヒドロキシエチル) イソニコチンアミ ド等が例示される。アミド誘導体としては、ホルムアミ ド、N-メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルム アミド、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、プロピオンアミド、ベンズ アミド等が例示される。イミド誘導体としては、フタル イミド、サクシンイミド、マレイミド等が例示される。 [0067] 更に、下記一般式(80) 及び(81) で 示される塩基性化合物を配合することもできる。

[0068] 【化19】

(80)

(81)

ル基、n-ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル 基、n-ペンチル基、イソペンチル基、ヘキシル基、ノ ニル基、デシル基、ドデシル基、トリデシル基、シクロ ベンチル基、シクロヘキシル基等が挙げられる。 【0071】更に、R32とR33、R32とR34、R33とR "¹、R"²とR"²とR"⁴、R"²とR"が環を形成する場 合、その環の炭素数は1~20、より好ましくは1~ 8、更に好ましくは1~6であり、またこれらの環は炭 素数1~6、特に1~4のアルキル基が分岐していても

【0072】n、o、pはそれぞれ0~20の整数であ り、より好ましくは1~10、更に好ましくは1~8の 整数である。

【0073】上記(80)、(81)の化合物として具 体的には、トリス (2-(メトキシメトキシ) エチル) アミン、トリス {2-(メトキシエトキシ) エチル} ア ミン、トリス[2-{(2-メトキシエトキシ)メトキ シ} エチル] アミン、トリス {2-(2-メトキシエト キシ) エチル} アミン、トリス {2-(1-メトキシエ トキシ) エチル} アミン、トリス {2-(1-エトキシ エトキシ) エチル} アミン、トリス {2-(1-エトキ ヒドロキシエトキシ)エトキシ}エチル]アミン、4, 7, 13, 16, 21, 24-ヘキサオキサー1, 10 -ジアザビシクロ[8.8.8] ヘキサコサン、4, 7, 13, 18-テトラオキサー1, 10-ジアザビシ クロ[8.5.5] エイコサン、1,4,10,13-テトラオキサー7、16-ジアザビシクロオクタデカ ン、1-アザ-12-クラウン-4、1-アザ-15-クラウン-5、1-アザ-18-クラウン-6等が挙げ られる。特に第三級アミン、アニリン誘導体、ピロリジ ン誘導体、ビリジン誘導体、キノリン誘導体、アミノ酸 10 誘導体、水酸基を有する含窒素化合物、ヒドロキシフェ ニル基を有する含窒素化合物、アルコール性含窒素化合 物、アミド誘導体、イミド誘導体、トリス(2-(メト キシメトキシ) エチル) アミン、トリス {2-(2-メ トキシエトキシ) エチル} アミン、トリス[2-{(2 -メトキシエトキシ) メチル} エチル] アミン、1-ア ザー15-クラウン-5等が好ましい。

37

【0074】なお、上記塩基性化合物は1種を単独で又は2種類以上を組み合わせて用いることができ、その配合量は前ベース樹脂100部に対して0.01~2部、特に0.01~1部が好適である。配合量が0.01部未満であると添加剤としての効果が十分に得られない場合があり、2部を超えると解像度や感度が低下する場合がある。

【0075】次に、溶解阻止剤としては、酸の作用によりアルカリ現像液への溶解性が変化する分子量3,000以下の化合物、特に2,500以下の低分子量フェノールあるいはカルボン酸誘導体の一部あるいは全部を酸に不安定な置換基で置換した化合物を挙げることができる。酸不安定基としては本発明に挙げられるフッ素を含むものであってもよいが、従来のフッ素を含まないものでもよい。

【0076】分子量2、500以下のフェノールあるい はカルボン酸誘導体としては、4,4'-(1-メチル エチリデン) ビスフェノール、[1,1'-ビフェニル -4,4'-ジオール]2,2'-メチレンピス[4-メチルフェノール]、4、4-ビス(4'-ヒドロキシ フェニル) 吉草酸、トリス(4-ヒドロキシフェニル) メタン、1, 1, 1-トリス(4'-ヒドロキシフェニ **ル) エタン、1, 1, 2-トリス (4'-ヒドロキシフ** ェニル) エタン、フェノールフタレイン、チモールフタ レイン、3,3'-ジフルオロ[(1,1'-ビフェニ ル) 4, 4' -ジオール]、3, 3', 5, 5' ーテト **ラフルオロ [(1, 1'-ピフェニル) -4, 4'-ジ** オール]、4,4'-[2,2,2-トリフルオロ-1 - (トリフルオロメチル) エチリデン] ビスフェノー ル、4、4'ーメチレンピス[2ーフルオロフェノー ル]、2,2'-メチレンピス[4-フルオロフェノー ル]、4、4'-イソプロピリデンピス[2-フルオロ フェノール]、シクロヘキシリデンビス [2 -フルオロ 50 シ) フェニル) メタン、トリス(<math>4 - (2 ' -テトラヒ

フェノール]、4, 4' - [(4-フルオロフェニル) **メチレン] ビス [2 – フルオロフェノール] 、4, 4'** -メチレンビス[2,6-ジフルオロフェノール]、 4, 4' - (4-フルオロフェニル) メチレンピス [(2-ヒドロキシ-5-フルオロフェニル)メチル] -4-フルオロフェノール、2,6-ビス[(4-ヒド ロキシー3-フルオロフェニル) メチル] -4-フルオ ロフェノール、2、4ーピス[(3ーヒドロキシー4ー ヒドロキシフェニル) メチル] -6-メチルフェノール 等が挙げられ、酸に不安定な置換基としては、式(2) 2)~(24)と同様のものが挙げられる。 【0077】好適に用いられる溶解阻止剤の例として は、3,3',5,5'-テトラフルオロ[(1,1' -ピフェニル) -4, 4' -ジ-t-ブトキシカルボニ ル]、4,4'-[2,2,2-トリフルオロー1-(トリフルオロメチル) エチリデン] ビスフェノールー 4, 4' -ジ-t-ブトキシカルボニル、ビス(4-(2'-テトラヒドロピラニルオキシ)フェニル)メタ ン、ピス(4-(2'-テトラヒドロフラニルオキシ) フェニル) メタン、ビス (4-tert-ブトキシフェ ニル) メタン、ビス (4-tert-ブトキシカルボニ ルオキシフェニル) メタン、ビス (4-tertープト キシカルボニルメチルオキシフェニル) メタン、ビス (4-(1'-エトキシエトキシ) フェニル) メタン、 ビス (4-(1'-エトキシプロピルオキシ) フェニ ル) メタン、2, 2-ビス(4'-(2'-テトラヒド ロビラニルオキシ))プロパン、2,2-ビス(4'-(2'-テトラヒドロフラニルオキシ)フェニル)プロ パン、2, 2-ビス(4'-tert-プトキシフェニ ル) プロパン、2, 2-ビス(4'-tert-ブトキ シカルボニルオキシフェニル)プロパン、2,2-ビス。 (4-tert-ブトキシカルボニルメチルオキシフェ ニル) プロパン、2, 2-ビス(4'-(1'-エトキ: シエトキシ)フェニル)プロパン、2,2-ビス(4' - (1'-エトキシプロピルオキシ)フェニル)プロバ ン、4、4-ピス(4'-(2'-テトラヒドロピラニ ルオキシ)フェニル)吉草酸tert-ブチル、4,4 -ビス(4'-(2'-テトラヒドロフラニルオキシ) フェニル) 吉草酸tert-ブチル、4,4-ピス (4'-tert-ブトキシフェニル) 吉草酸tert -ブチル、4, 4-ビス(4-tert-ブトキシカル ボニルオキシフェニル) 吉草酸 tert-ブチル、4, 4-ビス(4'-tert-ブトキシカルボニルメチル オキシフェニル)吉草酸tert-ブチル、4.4-ビ ス (4' - (1' -エトキシエトキシ) フェニル) 吉草 ・ 酸tert-ブチル、4,4-ピス(4'-(1'-エ トキシプロピルオキシ)フェニル) 吉草酸 tertーブ チル、トリス(4-(2'-テトラヒドロピラニルオキ

ドロフラニルオキシ)フェニル)メタン、トリス(4tert-ブトキシフェニル) メタン、トリス (4-t ertープトキシカルボニルオキシフェニル)メタン、 トリス(4-tert-ブトキシカルボニルオキシメチ ルフェニル) メタン、トリス(4-(1'-エトキシエ トキシ) フェニル) メタン、トリス(4-(1'-エト キシプロピルオキシ)フェニル)メタン、1,1,2-トリス(4'-(2'-テトラヒドロピラニルオキシ) フェニル) エタン、1, 1, 2 -トリス (4' - (2')ーテトラヒドロフラニルオキシ)フェニル)エタン、 1, 1, 2-トリス (4'-tert-ブトキシフェニ ル) エタン、1, 1, 2-トリス (4'-tertーブ トキシカルボニルオキシフェニル) エタン、1、1、2 -トリス(4'-tert-ブトキシカルボニルメチル オキシフェニル) エタン、1, 1, 2-トリス(4'-(1'-エトキシエトキシ)フェニル)エタン、1, 1, 2-トリス(4'-(1'-エトキシプロピルオキ シ) フェニル) エタン、2-トリフルオロメチルベンゼ ンカルボン酸1、1-t-ブチルエステル、2-トリフ ルオロメチルシクロヘキサンカルボン酸-t-ブチルエ 20 ステル、デカヒドロナフタレン-2,6-ジカルボン酸 -t-ブチルエステル、コール酸-t-ブチルエステ ル、デオキシコール酸-t-ブチルエステル、アダマン タンカルボン酸-t-ブチルエステル、アダマンタン酢 酸-t-ブチルエステル、[1, 1'-ビシクロヘキシ ル-3,3',4,4'-テトラカルボン酸テトラ-t - ブチルエステル] 等が挙げられる。

39

【0078】本発明のレジスト材料中における溶解阻止 剤の添加量としては、レジスト材料中の固形分100部 に対して20部以下、好ましくは15部以下である。2 0部より多いとモノマー成分が増えるためレジスト材料 の耐熱性が低下する。

【0079】本発明のレジスト材料には、上記成分以外 に任意成分として塗布性を向上させるために慣用されて いる界面活性剤を添加することができる。なお、任意成 分の添加量は、本発明の効果を妨げない範囲で通常量と することができる。

【0080】ととで、界面活性剤としては非イオン性の ものが好ましく、パーフルオロアルキルポリオキシエチ レンエタノール、フッ素化アルキルエステル、パーフル オロアルキルアミンオキサイド、パーフルオロアルキル EO付加物、含フッ素オルガノシロキサン系化合物等が 挙げられる。例えばフロラード「FC-430」、「F C-431」(いずれも住友スリーエム(株)製)、サ ーフロン「S-141」、「S-145」(いずれも旭 硝子(株)製)、ユニダイン「DS-401」、「DS -403」、「DS-451」(いずれもダイキン工業 (株) 製)、メガファック「F-8151」(大日本イ ンキ工業(株)製)、「X-70-092」、「X-7 0-093」(いずれも信越化学工業(株)製)等を挙 50 -1との共重合(1:1)・

げることができる。好ましくは、フロラード「FC-4 30」(住友スリーエム(株)製)、「X-70-09 3」(信越化学工業(株)製)が挙げられる。

【0081】本発明のレジスト材料を使用してパターン を形成するには、公知のリソグラフィー技術を採用して 行うことができる。例えばシリコンウエハー等の基板上 にスピンコーティング等の手法で膜厚が0.1~1.0 μπとなるように塗布し、これをホットプレート上で6 0~200℃、10秒~10分間、好ましくは80~1 10 50℃、30秒~5分間ブリベークする。次いで目的の バターンを形成するためのマスクを上記のレジスト膜上 にかざし、遠紫外線、エキシマレーザー、X線等の高エ ネルギー線もしくは電子線を露光量1~200mJ/c m'程度、好ましくは10~100mJ/cm'程度とな るように照射した後、ホットプレート上で60~150 ℃、10秒~5分間、好ましくは80~130℃、30 秒~3分間ポストエクスポージャベーク(PEB)す る。更に、0.1~5%、好ましくは2~3%のテトラ メチルアンモニウムヒドロキシド (TMAH) 等のアル カリ水溶液の現像液を用い、10秒~3分間、好ましく は30秒~2分間、浸漬 (dip)法、パドル (pud dle)法、スプレー(spray)法等の常法により 現像することにより基板上に目的のパターンが形成され る。なお、本発明材料は、特に高エネルギー線の中でも 254~120nmの遠紫外線又はエキシマレーザー、 特に193nmのArF、157nmのF₂、146n moKr₂, 134nmoKrAr, 121nmoAr₂ などのエキシマレーザー、X線及び電子線による微細パ ターンニングに最適である。また、上記範囲を上限及び 30 下限から外れる場合は、目的のパターンを得ることがで きない場合がある。

[0082]

【発明の効果】本発明のレジスト材料は、高エネルギー 線に感応し、200mm以下、特に170mm以下の波 長における感度が優れているうえに、エステル側鎖の環 状アルキル基の導入によりプラズマエッチング耐性が向 上し、それと同時に優れた解像性を有することがわかっ た。従って本発明のレジスト材料は、これらの特性によ り、特にF、エキシマレーザーの露光波長での吸収が小 さいレジスト材料となりうるもので、微細でしかも基板 に対して垂直なパターンを容易に形成でき、このため超 LSI製造用の微細パターン形成材料として好適であ

[0083]

【実施例】以下、合成例及び実施例を示して本発明を具 体的に説明するが、本発明は下記実施例に制限されるも のではない。

【0084】[合成例1] メタクリル酸 {(2-シクロ ヘキシル) ヘキサフルオロイソプロピル} と下記モノマ

500mlのフラスコ中でメタクリル酸 { (2-シクロ ヘキシル) ヘキサフルオロイソプロピル} 13.0gと 下記モノマー1の7. 0gをトルエン100mlに溶解 させ、十分に系中の酸素を除去した後、開始剤AIBN 0.54gを仕込み、60℃まで昇温して24時間重合 反応を行った。

41

【0085】得られたポリマーを精製するために、反応 混合物をヘキサンに注ぎ、得られた重合体を沈澱させ た。更に得られたポリマーをテトラヒドロフランに溶か し、ヘキサン5 L中に注いでポリマーを沈澱させる操作 10 を二回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。と のようにして得られた14.0gの白色重合体は光散乱 法により重量平均分子量が8500g/molであり、 GPC溶出曲線より分散度(=Mw/Mn)が1.67 の重合体であることが確認できた。本ポリマーは、1H -NMRの測定結果より、メタクリル酸((2-シクロ ヘキシル) ヘキサフルオロイソプロピル} とモノマー 1 が49:51の組成比で含まれていることがわかった。 [0086]

【化20】

【0087】[合成例2] メタクリル酸 {2-(2-ノ ルボルニル) ヘキサフルオロイソプロピル とモノマー 30 1の共重合(1:1)

500mlのフラスコ中でメタクリル酸 {2-(2-ノ ルボルニル) ヘキサフルオロイソプロピル} 13.2g とモノマー1の6.8gをトルエン100mlに溶解さ せ、十分に系中の酸素を除去した後、開始剤AIBN 0.53gを仕込み、60℃まで昇温して24時間重合 反応を行った。

【0088】得られたポリマーを精製するために、反応 混合物をヘキサンに注ぎ、得られた重合体を沈澱させ た。更に得られたポリマーをテトラヒドロフランに溶か 40 し、ヘキサン5 L中に注いでポリマーを沈澱させる操作 を二回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。と のようにして得られた14.3gの白色重合体は光散乱 法により重量平均分子量が8,900g/molであ り、GPC溶出曲線より分散度 (=Mw/Mn)が1. 76の重合体であることが確認できた。本ポリマーは、 ¹H-NMRの測定結果より、メタクリル酸{2-(2 - ノルボルニル) ヘキサフルオロイソプロピル) とモノ

マー1が49:51の組成比で含まれていることがわか

[0089] [合成例3] メタクリル酸 {2-(2-ア ダマンチル) ヘキサフルオロイソプロビル} とモノマー 1の共重合(1:1)

500mlのフラスコ中でメタクリル酸 {2-(2-ア ダマンチル) ヘキサフルオロイソプロピル} 13.7g とモノマー1の6.3gをトルエン100m1に溶解さ せ、十分に系中の酸素を除去した後、開始剤AIBN 0.49gを仕込み、60℃まで昇温して24時間重合 反応を行った。

【0090】得られたポリマーを精製するために、反応 混合物をヘキサンに注ぎ、得られた重合体を沈澱させ た。更に得られたポリマーをテトラヒドロフランに溶か し、ヘキサン5 L中に注いでポリマーを沈澱させる操作 を二回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。と のようにして得られた14.7gの白色重合体は光散乱 法により重量平均分子量が9、200g/molであ り、GPC溶出曲線より分散度(=Mw/Mn)が1. 20 67の重合体であることが確認できた。本ポリマーは、 ¹H-NMRの測定結果より、メタクリル酸{2-(2 -アダマンチル) ヘキサフルオロイソプロビル} とモノ マー1が49:51の組成比で含まれていることがわか った。

【0091】[実験例]次に、上記ポリマーの透過率を 下記の方法で測定した。その結果を表1に示す。得られ たポリマー1gをプロピレングリコールモノメチルエー テルアセテート (PGMEA) 10gに十分に溶解さ せ、0.2μmのフィルターで濾過して、ポリマー溶液 を調製した。

【0092】比較例用ポリマー1として、分子量10,... 000、分散度 (Mw/Mn) 1.10の単分散ポリヒ ドロキシスチレンの水酸基の水素原子の30%をテトラ ヒドロピラニル基で置換したポリマーを合成し、透過率 比較例ポリマー1とした。分子量15,000、分散度 1. 7のポリメチルメタクリレートを比較例用ポリマー: 2とした。メタ/パラ比40/60で分子量9,00 0、分散度2.5のノボラックポリマーを比較例用ポリ マー3とした。

【0093】ポリマー溶液をMgF,基板にスピンコー ティング、ホットプレートを用いて100℃で90秒間 ベークし、厚さ100nmのポリマー層をMgFz基板 上に作成した。真空紫外光度計(日本分光製、VUV2 005) を用いて248nm、193nm、157nm における透過率を測定した。

[0094]

【表 1 】

| .5 | | | |
|--------------|--------|--------|--------|
| ¥, 114- | 透過率(%) | 透過率(%) | 透過率(%) |
| 4' 7' | 248nm | 193 mm | 157nm |
| 合成例1ポリマー | 93 | 90 | 45 |
| 合成例2ポタマー | 92 | 90 | 42 |
| 合成例3ポリマー | 92 | 90 | 39 |
| 比較例用 1ポリケー | 90 | 5 | 15 |
| 比較例用 2 ポ リャー | 91 | 80 | .12 |
| 比較例用 3ポリー | 82 | 6 | 17 |

【0095】[実施例、比較例]上記ポリマー及び下記 * [0096] に示す成分を表2に示す量で用いて常法によりレジスト 【化21】 液を調製した。 *10

CF₃SO₃⁻

PAG1

PAG2

TMMEA

【0097】次に、得られたレジスト液を、シリコンウ エハーにDUV-30 (日産化学製)を55nmの膜厚 で成膜して、KrF光 (248 nm)で反射率を1%以 ートを用いて100℃で90秒間ベークし、レジストの 厚みを300nmの厚さにした。

【0098】 これをエキシマレーザーステッパー (ニコ ン社、NSR-2005EX8A, NA-0. 5、σ 0. 7. 通常照明)を用いて、4 mm角の露光面積で露光

量を変えながらステッピング露光し、露光後直ちに11 0℃で90秒間ベークし、2.38%のテトラメチルア ンモニウムヒドロキシドの水溶液で60秒間現像を行っ 下に抑えた基板上にスピンコーティングし、ホットプレ 40 て、露光量と残膜率の関係を求めた。膜厚が0になった 露光量をEthとして、レジストの感度を求めた。結果 を表2に示す。

[0099]

【表2】

| 40 | | | | | | |
|-------|-------|------------|-------|----------|--------|--|
| **5~ | 酸発生剤 | . 塩基 | 溶解阻止剤 | 溶媒 | Eth 感度 | |
| (重量部) | (重量部) | (重量部) | (重量部) | (重量部) | | |
| 合成例1 | PAG1 | トタブ・チャクミン | | PGMEA | 25 | |
| (100) | (2) | (0.1) | | (1, 000) | | |
| 合成例2 | PAG1 | トタブチがスミン | _ | PCMEA | 20 | |
| (100) | (2) | (0. 1) | _ | (1, 000) | | |
| 合成例3 | PAG1 | トタブチがミン | _ | PCMEA | 28 | |
| (100) | (2) | (0. 1) | | (1,000) | | |
| 合成例1 | PAG1 | トタブ・チャブミン | DRI | PGMEA | 22 | |
| (100) | (2) | (0. 1) | (10) | (1,000) | 22 | |
| 合成例1 | PAG2 | トタブチルアミン | _ | PGMEA | 12 | |
| (100) | (2) | (0.1) | | (1,000) | 12 | |
| 合成例1 | PAG1 | トリエタノールアミン | _ | POMEA | 23 | |
| (100) | (2) | (0. 1) | | (1, 000) | 2.5 | |
| 合成例1 | PAG1 | TIMIEA | _ | PGMEA | 25 | |
| (100) | (2) | (0. 2) | 1 | (1,000) | 20 | |

【0100】表1、2の結果より、F₂(157nm) の波長においても十分な透明性を確保でき、KrFの露* *光において、露光量の増大に従って膜厚が減少し、ボジ 型レジストの特性を示すことがわかった。

【手続補正書】

【提出日】平成13年11月13日(2001.11.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正内容】

【0006】本発明は上記事情に鑑みなされたものであり、300nm以下、特に下、(157nm)、Kr、(146nm)、KrAr(134nm)、Ar、(126nm)などの真空紫外光における透過率に優れた化学増幅レジスト材料のベースポリマーとして有用な新規高分子化合物並びにこれを含む化学増幅レジスト材料及びこれを用いたパターン形成方法を提供することを目的にする。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0081

【補正方法】変更

【補正内容】

【0081】本発明のレジスト材料を使用してパターンを形成するには、公知のリソグラフィー技術を採用して行うことができる。例えばシリコンウエハー等の基板上にスピンコーティング等の手法で膜厚が0.1~1.0%

※μπとなるように塗布し、これをホットプレート上で6 0~200℃、10秒~10分間、好ましくは80~1 50℃、30秒~5分間プリベークする。次いで目的の パターンを形成するためのマスクを上記のレジスト膜上 にかざし、遠紫外線、エキシマレーザー、X線等の高エ ネルギー線もしくは電子線を露光量1~200mJ/c m²程度、好ましくは10~100mJ/cm²程度とな るように照射した後、ホットプレート上で60~150 ℃、10秒~5分間、好ましくは80~130℃、30 秒~3分間ポストエクスポージャベーク(PEB)す る。更に、0.1~5%、好ましくは2~3%のテトラ メチルアンモニウムヒドロキシド (TMAH)等のアル カリ水溶液の現像液を用い、10秒~3分間、好ましく は30秒~2分間、浸漬 (dip) 法、パドル (pud dle)法、スプレー(spray)法等の常法により 現像することにより基板上に目的のパターンが形成され る。なお、本発明材料は、特に高エネルギー線の中でも 254~120nmの遠紫外線又はエキシマレーザー、 特に193nmのArF、157nmのF₂、146n mokr, 134nmokrAr, 126nmoAr, などのエキシマレーザー、X線及び電子線による微細パー ターンニングに最適である。また、上記範囲を上限及び 下限から外れる場合は、目的のパターンを得ることがで きない場合がある。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.'

識別記号

FΙ

テーマコート' (参考)

C 0 8 L 33/06

35/02

G03F 7/039

6 0 1

 $C \cap B$

CO8L 33/06

35/02

GO3F 7/039 601

HO1L 21/027

(72)発明者 原田 裕次

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1

信越化学工業株式会社合成技術研究所内

(72)発明者 渡辺 淳

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社合成技術研究所内

(72)発明者 畠山 潤

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1

信越化学工業株式会社合成技術研究所内

(72)発明者 河合 義夫

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1

信越化学工業株式会社合成技術研究所内

(72)発明者 笹子 膀

大阪府高槻市幸町1番1号

(72)発明者 遠藤 政孝

大阪府高槻市幸町1番1号

(72)発明者 岸村 眞治

大阪府高槻市幸町1番1号

(72)発明者 大谷 充孝

埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラ

ル硝子株式会社化学研究所内

(72)発明者 宮澤 覚

埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラ

ル硝子株式会社化学研究所内

HO1L 21/30

502R

(72)発明者 堤 憲太郎

埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラ

ル硝子株式会社化学研究所内

(72)発明者 前田 一彦

東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1

セントラル硝子株式会社内

Fターム(参考) 2H025 AA09 AB16 AC04 AC06 AD03

BEOO BEO7 BE10 BF02 BF11

BG00 CB43 CC03 CC20 FA17

4J002 BG041 BG051 BG071 EB116

EB146 EJ038 EJ058 EJ068

EN027 EN067 EN1.07 EN1.17

EU137 EV216 EV296 GP03

4J100 AL08P AL08T AL46S AM21T

AM47R AR09Q BA02Q BA02R

BA02S BA03Q BA03R BA03S

BA03T BA16H BA20Q BA20R

BA20S BA40T BA43S BB18P

BC03P BC09P BC26P BC26T

BCZ8P BC43Q BC43R BC53T BC60Q BC60R BC60S BC60T

BC65T CA04 CA05 CA06

HA08 JA38